

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2016-053

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与恒硕科技股份有限公司合资经营设立子公司并签署〈合作协议〉的议案》，同意上海新阳和恒硕科技股份有限公司（以下简称“恒硕科技”）共同投资设立合资公司，承担晶圆级封装合金焊接球项目，研发并销售高质量的锡合金焊接球。合资公司注册资本为人民币 3000.00 万，其中上海新阳出资 1650 万元人民币，持有合资公司 55%股份；恒硕科技出资 1350 万元人民币，持有合资公司 45%股份。具体内容详见 2016 年 3 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告（公告编号：2016-009）。

近日，合资公司取得了由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310000MA1J1G5E1W

名 称：芯封（上海）材料科技有限公司

类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住 所：上海市松江区思贤路 3600 号 8 幢

法定代表人：王福祥

注册资本：人民币 3000.0000 万元整

成立日期：2016 年 7 月 11 日

营业期限：2016 年 7 月 11 日至 2046 年 7 月 10 日

经营范围：制造、加工、研发晶圆级封装锡球产品，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发及相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

公司将持续关注该项目的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日